製品仕様書	No,	IS-9199	B 来歷/REV.	1
PRODUCT SPECIFICATION	頁		1/3	
<u> </u>	制定年月 ISSUE D		3-2- '07	
SUBJECT: SERIES 9199 2.0 mm pitch board to board connector	改訂年月 REVISEI		3-12 '07	

<u> 1</u> . 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製9199シリーズ 2.0 mmピッチ LCD ソケットに関する仕様及び性能上の 必要事項について規定する。

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 (鉛フリーめっき品に適用する)

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 125V(AC,DC)

(2)最大定格電流 : 1A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4. 試験環境

特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

: 15∼35℃ 常温 : 25~85%RH

5. 特性 5.1 需复的特性

1.Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. Series 9199 2.0 mm pitch LCD soket.

2. Configurations dimensions and materials See the product drawing attached. (Applied for Pb free plate product)

3.Rating

(1)Maximum rating voltage: 125 V (AC,DC)

(2)Maximum rating current: 1A

(3)Temperature range : -40~+105°C

4.Environmental condition

All performance test, unless otherwise specified, is taken

as per following environmental condition. Ambient temperature : 15~35℃ : 25~85%RH Ambient humidity

5.Performance

5-1.電気的特性		<u>ces</u>	
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期值: 20mΩ以下
	Contact resistance	抵抗計にて測定する。	各試験後:40mΩ以下
		It shall be measured by the dry electric circuit specified	Initial : $20m\Omega$ or below
		as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.	After each test : 40 m Ω or below
2	耐電圧	隣接する極間にAC 500V を1分間印加する。	絶縁破壊等異常のない事。
	Dielectric	AC 500 V shall be applied for one minute to between next	Should not have any changes.
	withstanding	terminals.	
	voltage		
3	絶縁抵抗	隣接する極間に DC 500V を印加し、測定する。	初期値:1000MΩ以上
	Insulation	It shall be measured when 500V DC is applied to between next	Initial: 1 0 0 0 MΩ or more
	resistance	terminals.	耐湿試験後:100ΜΩ以上
			After humidity test: 100MΩ or more
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ
			変形、変色等のない事。
	Appearance	Visual	Should not have any flaw, scratch,
			discoloration and crushed .

この 松油的性州 5-2 Functional performance

5-2.機械的特性		<u>ice</u>	
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	コンタクトの保持力	コンタクトに25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	4.9N以上
		ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。	
	Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm	4.9N or more.
	force	per minute, and measured the force when the contact	
		begins to remove from the housing.	
2	挿抜力	ソケットと LCD を 25mm/分の速度で挿抜を行ない、	初期値にて/Initial(単極にて)
		この時の荷重を測定する。	挿入力: 4.41N以下/極
	Insertion/extraction	The socket and LCD shall be mated and unmated	抜去力: 0.49N以上/極
	force	at the speed of 25mm per minute and measured the	Insertion force: 4.41N or
		force of insertion and extraction.	below / terminal
			Extraction force: 0.49N or
			more / terminal
3	挿抜耐久性	ソケットと LCD を 25mm/分の速度で 20 回繰り返し	40mΩ以下
	·	挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。	
	Insertion/extraction	The socket and LCD shall be mated and unmated	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below
	endurance	20 times at the speed of 25mm per minute and measured	
		the contact resistance after the test.	

					1	i
No.	IS-9199B	来歷/REV.	1	頁/Page	2/3	ĺ

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
4	振動試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、振幅 1.5 mm、振動周波数	試験中1μs 以上の瞬断のない事。
		10~55~10Hz 毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な	試験後:40mΩ以下
		3方向に各々 2時間 計6時間 の振動を加える。試験中瞬断の	
	Vibration test	有無を確認する。試験後接触抵抗を測定する。	
		The connector and LCD mated is vibrated in the frequency r	Discontinuity : $1 \mu s$ or below
		ange of 10~55~10Hz per minute and in the constant vibrati	After the test : $40 \text{m}\Omega$ or below
		on amplitude 1.5 mm. This motion is applied for period of	
		6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions	
		(X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested	
		the discontinuity of the contact current during the test and	
	According to the	measured the contact resistance after the test.	Show I a think of the second
5	衝擊試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度	試験中1μs 以上の瞬断の無いこと
		490m/s ² 、衝撃作用時間11ms を X,Y,Z 方向の	試験後:40mΩ以下
		6面に各3回加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後	
	C1 . 1 . 4 4 :	接触抵抗を測定する。	TO 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Shock test	The connector LCD mated are installed in the machine. The	Discontinuity : $1 \mu s$ or below
		y are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral	After the test : $40 \mathrm{m}\Omega$ or below
		perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified;	
		acceleration of 490m/s ² and shock pulses for a duration of	
		11ms . It shall be tested the discontinuity of the contact current during the test and measured the contact resistance	
		after the test.	
		after the test.	

5-3.環境特性 5-3.Environmental performance

5-3. ⁵ -3. 5-3. Environme		5-3, Environmental performance	
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	耐熱性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 105±2℃の雰囲気中に 96 時間放	40mΩ以下
		置し、放置後接触抵抗を測定する。	
	Heat resistance	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber $105\pm$	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below
		2°C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the	
		test.	
2	耐湿性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 90~95%RH	40mΩ以下
		の雰囲気中に96時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。	
	Humidity	The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 40	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below
		± 2 °C, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resis	·
		tance after the test.	
3	耐寒性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度-40±2℃の雰囲気中に 96 時間放置	40mΩ以下
		し、放置後接触抵抗を測定する。	
	Cold resistance	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber -40 \pm	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below
		2°C for 96 hours. It shall be measured the contact resistance	
		after the test.	
4	SO2ガス試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 75%、濃度 10	40mΩ以下
		±3ppm.の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	10.00.11
	SO ₂ gas test	The connector and LCD mated is exposed in the SO ₂ gas chamber 40	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below
		$\pm 2^{\circ}$ C,75%RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact	
-	TT 0 18 - 14 - 14 - 14	resistance after the test.	10 ONT
5	H ₂ Sガス試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2℃,相対湿度 75%、濃度 3	40mΩ以下
	TI C	±1ppm の雰囲気中に96時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below
	H ₂ S gas test	The connector and LCD mated is exposed in the H ₂ S gas chamber 40	40IIIS2 or below
		±2°C,75%RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact	
6	耐アンモニア	resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、濃度 28%のアンモニア水を入れた雰囲気	40mΩ以下
6		コイクタと LOD を吹音した状態に C、優反 20mの プラモニア 小を入れた分面	40111821/
	試験	中に40 万同以直 9 る。 The connector and LCD mated is exposed in the chamber with 28%	40mΩ or below
	Ammonia gas test	Ammonia solution for 40 minutes.	TOTTISZ OI DETOW
	iesi	Allimonia solution for 40 minutes.	

No	IS-9199B	来歷/REV.	1	頁/Page	3/3
140.	10 01000	/K/IE/ 1011 V.	, ,	H/ Lage	0/0

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
6	冷熱衝撃試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて下図の温度条件を 1 州かとして 10 州	40mQ以下
. 0	(中然)里等武殿		401115254 [
	771 1	別実施し、試験後接触抵抗を測定する。	40
	Thermal	The connector and LCD mated is exposed 10 cycles in the following	$40 \mathrm{m}\Omega$ or below
	shock test	temperature. It shall be measured the contact resistance after	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		the test.	ant
	1	+105± 2 ℃	
		30min	Table 1
		Ambient	
		常温 temperature	
		30min	
		-55± 3℃	
		1cycle	
7	温湿度サイクル試験	コネクタと LCD を嵌合した状態で下図の温湿度条件を 1 サイクルとして	40mΩ以下
		10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。	
	Humidity	The connector and LCD mated is exposed 10 cycles in the following	$40\mathrm{m}\Omega$ or below
	Resistance	conditions. It shall be measured the contact resistance after	
	(cycling)	the test.	
	, ,		
		+80±2℃ ————————————————————————————————————	
		90~95%RH	
		00 00/02	
		-20±3℃	
		\Leftrightarrow 2h \Rightarrow \Leftrightarrow 2h \Rightarrow \Leftrightarrow 2h \Rightarrow	
		1 cycle	
		2 0,000	

	5-4.	その他の特性	5-4.Other performance	
N	lo.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
	1	半田付け性	コネクタの半田付け部をフラックスに浸漬した後、245±5℃の Sn-Ag-Cu 系の鉛フリー槽に3±0.5秒浸す。	浸した面積の 95%以上に半田が むらなく 付着する事。
		Solderability	The terminal of connector shall be put into the flux and dipped into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 245 ± 5 °C, 3 ± 0.5 s.	Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath.
	2	半田耐熱性	下記条件にて、半田耐熱試験を行う。	端子のガタ、割れ等異常のない事。
	-	Resistance to soldering heat	The connector shall be tested resistance to soldering heat in the following conditions. (1)リフローの場合/In case of reflow	Should not have any flaw, scratch and crack.
			2 <u>40°CMAX(ピーウ温度)</u> (Peak temperature)	
			(30s) 200°CMIN. (予熱 150~180°C)	
			(pre-heat: from 150 to 180°C)	
			温度は基板パターン面の温度とする。	
			The temperature shall be measured on the surface of the PCB.	
			(2)手半田 の場合/ In case of manual soldering.	
			半田鏝温度 / temperature : 350±5℃	·
			浸漬時間 / time : 3±0.5s 基板厚 / thickness : t = 1.6 mm	
			基板厚/ tnickness : t — 1.6 mm (3)ディップの場合 / In case of dip.	
			半田槽温度 / temperature : 260±5℃	
			時 間 / time : 5±0.5s	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			基板厚/thickness : t=1.6 mm	